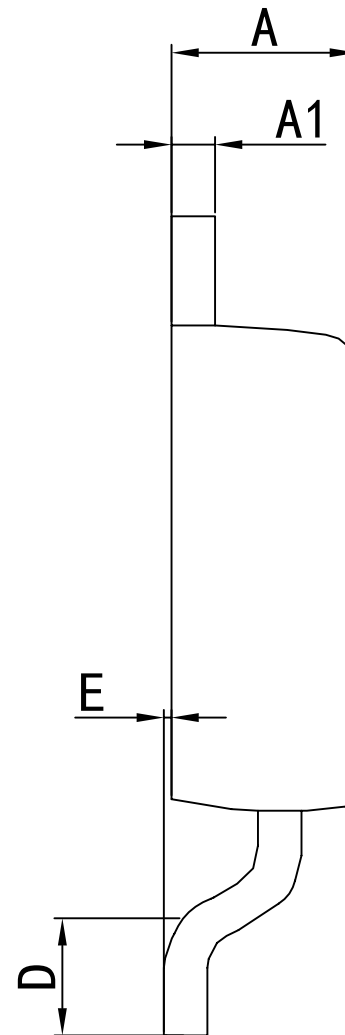
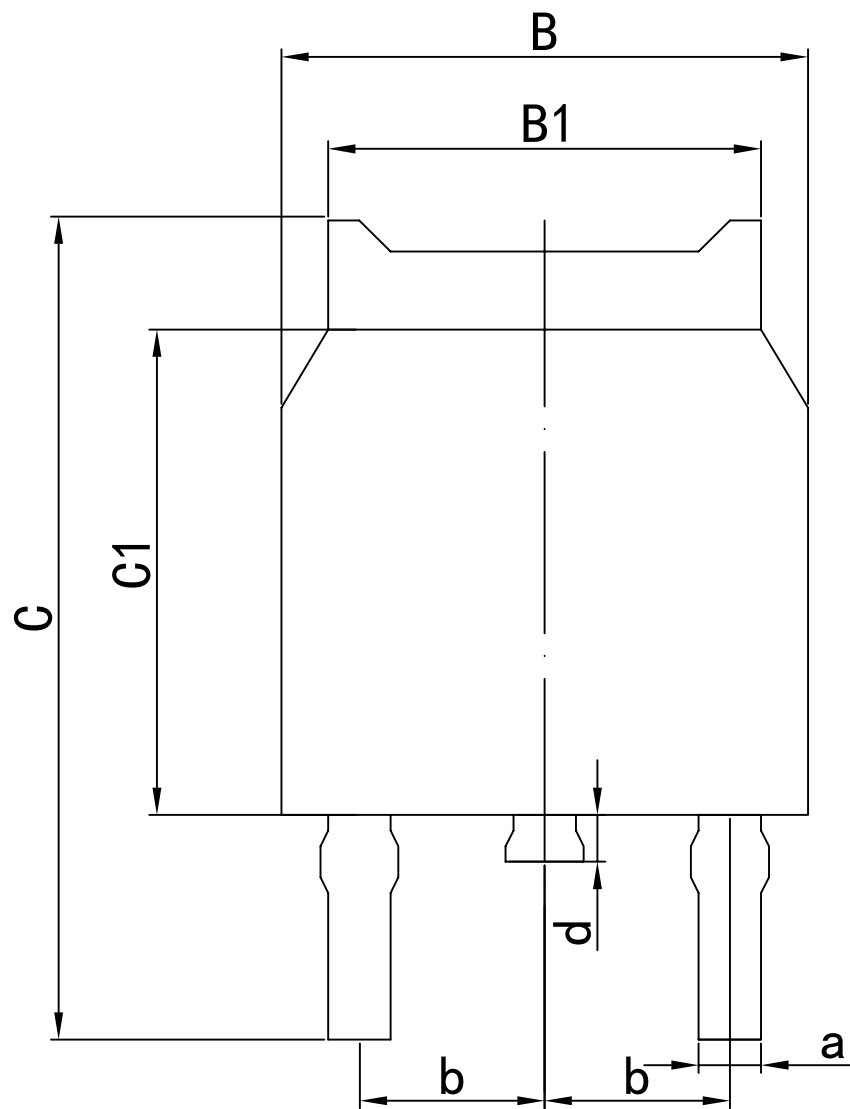




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



UNITT:mm

DIM.	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	a	d	b	
MIN	2.10	0.45	6.30	5.10	9.20	5.30	0.90	0.00	0.50	0.85	2.28	
MAX	2.50	0.70	6.75	5.50	10.6	6.30	1.75	0.23	0.80	1.05	BCS	

制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

T0252-2

文件名称:  
HG-T0252-2

文件编号:  
HGWXT-230031

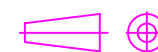
版本 VI.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-29

图纸幅面 A4



第一角法